



## 2024年6月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

2024年1月31日

上場会社名 レーザーテック株式会社 上場取引所 東  
コード番号 6920 URL <https://www.lasertec.co.jp/>  
代表者 (役職名) 代表取締役社長執行役員 (氏名) 岡林 理  
問合せ先責任者 (役職名) 取締役執行役員 (氏名) 三澤 祐太郎 TEL 045-478-7111  
四半期報告書提出予定日 2024年2月9日 配当支払開始予定日 2024年3月6日  
四半期決算補足説明資料作成の有無 : 有  
四半期決算説明会開催の有無 : 有 (アナリスト・機関投資家向け)

(百万円未満切捨て)

### 1. 2024年6月期第2四半期の連結業績（2023年7月1日～2023年12月31日）

#### (1) 連結経営成績（累計）

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する 四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2024年6月期第2四半期	94,989	72.4	31,752	75.2	31,302	72.9	22,198	63.4
2023年6月期第2四半期	55,100	49.2	18,124	41.6	18,108	38.0	13,582	39.5

(注) 包括利益 2024年6月期第2四半期22,012百万円 (62.6%) 2023年6月期第2四半期13,535百万円 (49.0%)

	1株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり 四半期純利益
	円 銭	円 銭
2024年6月期第2四半期	246.15	245.94
2023年6月期第2四半期	150.61	150.49

#### (2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
2024年6月期第2四半期	252,341	119,695	47.4	1,326.95
2023年6月期	271,574	109,142	40.2	1,209.99

(参考) 自己資本 2024年6月期第2四半期 119,674百万円 2023年6月期 109,121百万円

### 2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
2023年6月期	—	52.00	—	128.00	180.00
2024年6月期	—	73.00	—	—	—
2024年6月期(予想)	—	—	—	118.00	191.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 有

### 3. 2024年6月期の連結業績予想（2023年7月1日～2024年6月30日）

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属 する当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	195,000	27.6	67,000	7.6	67,000	5.2	49,000	6.1	543.32

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 有

※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）： 無  
新規 ー社 （社名）ー、除外 ー社 （社名）ー

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用： 無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 無
- ④ 修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む）	2024年6月期2Q	94,286,400株	2023年6月期	94,286,400株
② 期末自己株式数	2024年6月期2Q	4,098,909株	2023年6月期	4,102,594株
③ 期中平均株式数（四半期累計）	2024年6月期2Q	90,185,165株	2023年6月期2Q	90,181,865株

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

（将来に関する記述等についてのご注意）

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因によって大きく異なる可能性があります。

（四半期決算補足説明資料の入手方法）

当社は、2024年1月31日（水）に機関投資家及びアナリスト向けの第2四半期決算説明会を開催する予定です。この説明会で使用する決算説明資料については、開催にあわせて当社ウェブサイトに掲載する予定です。

## ○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報 .....	2
(1) 経営成績に関する説明 .....	2
(2) 財政状態に関する説明 .....	2
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 .....	2
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記 .....	3
(1) 四半期連結貸借対照表 .....	3
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 .....	5
四半期連結損益計算書	
第2四半期連結累計期間 .....	5
四半期連結包括利益計算書	
第2四半期連結累計期間 .....	6
(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 .....	7
(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項 .....	8
(継続企業の前提に関する注記) .....	8
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記) .....	8
3. 補足情報 .....	9
(1) 品目別生産実績 .....	9
(2) 品目別受注高及び受注残高 .....	9
(3) 品目別販売実績 .....	9

## 1. 当四半期決算に関する定性的情報

### (1) 経営成績に関する説明

当第2四半期連結累計期間における世界経済は、エネルギーや原材料価格の高騰は緩和傾向にあったものの、インフレ圧力は依然として高く、欧米諸国の政策金利の高止まりなどにより、景気減速が懸念されました。

当社グループの主要販売先である半導体業界では、サプライチェーン全体の在庫調整局面が続く中、スマートフォンやパソコンなどの最終需要に底打ちの兆しが見られました。しかしながら、半導体デバイスメーカーの多くは慎重な投資姿勢を継続し、最先端のEUV（極端紫外線）リソグラフィを用いた半導体製造能力の増強や次世代製造工程の開発に関わる投資も一定の水準に留まりました。

一方で、半導体市場は生成AIや車載向けを含めさまざまな用途で中長期的に拡大することが予想されており、世界各地で地政学リスクへの対応を目的とした政府主導による半導体工場の新設・増設計画が進められております。また、半導体デバイスは、継続的な微細化による高性能化や消費電力の低減が求められており、半導体製造装置市場も中長期的に成長を続けると見込まれています。

当第2四半期連結累計期間の売上高につきましては949億89百万円（前年同期比72.4%増加）となりました。

品目別に見ますと、半導体関連装置が810億71百万円（前年同期比81.9%増加）、その他が9億17百万円（前年同期比26.8%減少）、サービスが130億円（前年同期比40.1%増加）となりました。

連結損益につきましては、営業利益が317億52百万円（前年同期比75.2%増加）、経常利益が313億2百万円（前年同期比72.9%増加）、親会社株主に帰属する四半期純利益が221億98百万円（前年同期比63.4%増加）となりました。

### (2) 財政状態に関する説明

#### ①財政状態

当第2四半期連結会計期間末における総資産は2,523億41百万円となり、前連結会計年度末に比べ192億33百万円減少いたしました。これは主に、原材料及び貯蔵品が82億3百万円、仕掛品が22億23百万円増加したものの、未収入金が194億73百万円、受取手形、売掛金及び契約資産が85億11百万円減少したことによるものであります。

負債につきましては、当第2四半期連結会計期間末残高は1,326億45百万円となり、前連結会計年度末に比べ297億86百万円減少いたしました。これは主に、繰延収益が27億2百万円、買掛金が8億15百万円増加したものの、有償支給取引に係る負債が154億54百万円、未払法人税等が76億98百万円、短期借入金が50億円減少したことによるものであります。

株主資本にその他の包括利益累計額及び新株予約権を加えた純資産合計は1,196億95百万円となり、また自己資本比率は47.4%となりました。

#### ②キャッシュ・フロー

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ8億64百万円増加し、306億38百万円となりました。当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、189億52百万円の収入（前年同期比1.0%減少）となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益313億2百万円、売上債権の減少額83億29百万円、仕入債務の増加額48億40百万円などの収入要因が、法人税等の支払額159億25百万円、棚卸資産の増加額105億15百万円などの支出要因を上回ったことによるものであります。

投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、19億16百万円の支出（前年同期比89.4%減少）となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出14億44百万円、無形固定資産の取得による支出4億57百万円などによるものであります。

財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、165億51百万円の支出（前年同期は41億35百万円の収入）となりました。これは主に、配当金の支払額115億43百万円、短期借入金の減少額50億円などによるものであります。

### (3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2024年6月期の業績予想につきましては、為替変動の影響を鑑み、2023年8月7日に公表した業績予想を修正しております。詳細につきましては、本日（2024年1月31日）に開示しました「2024年6月期通期業績予想の修正、剰余金の配当（中間配当）及び配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

## 2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

## (1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2023年6月30日)	当第2四半期連結会計期間 (2023年12月31日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	29,773	30,638
受取手形、売掛金及び契約資産	21,611	13,099
仕掛品	131,056	133,280
原材料及び貯蔵品	21,017	29,220
未収入金	19,640	166
その他	8,029	7,494
貸倒引当金	△38	△13
流動資産合計	231,090	213,885
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	10,824	10,823
機械装置及び運搬具(純額)	3,468	2,896
工具、器具及び備品(純額)	834	958
リース資産(純額)	37	76
土地	13,146	13,146
建設仮勘定	113	114
有形固定資産合計	28,424	28,014
無形固定資産	6,164	5,176
投資その他の資産		
投資有価証券	1,625	1,674
退職給付に係る資産	56	—
繰延税金資産	3,892	3,245
その他	320	344
投資その他の資産合計	5,895	5,265
固定資産合計	40,484	38,456
資産合計	271,574	252,341

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2023年6月30日)	当第2四半期連結会計期間 (2023年12月31日)
<b>負債の部</b>		
流動負債		
買掛金	17,034	17,850
短期借入金	5,000	—
未払法人税等	15,867	8,168
前受金	95,155	91,758
繰延収益	6,168	8,871
賞与引当金	237	824
役員賞与引当金	906	409
有償支給取引に係る負債	15,458	3
その他	5,609	3,290
流動負債合計	161,438	131,178
固定負債		
退職給付に係る負債	455	466
株式給付引当金	267	675
資産除去債務	224	246
その他	46	78
固定負債合計	993	1,467
負債合計	162,432	132,645
純資産の部		
株主資本		
資本金	931	931
資本剰余金	1,207	1,290
利益剰余金	105,551	116,206
自己株式	△977	△976
株主資本合計	106,712	117,451
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	1,041	1,076
為替換算調整勘定	1,369	1,148
退職給付に係る調整累計額	△1	△1
その他の包括利益累計額合計	2,409	2,222
新株予約権	21	21
純資産合計	109,142	119,695
負債純資産合計	271,574	252,341

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書  
 (四半期連結損益計算書)  
 (第2四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 2022年7月1日 至 2022年12月31日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2023年7月1日 至 2023年12月31日)
売上高	55,100	94,989
売上原価	25,325	51,144
売上総利益	29,775	43,845
販売費及び一般管理費	11,650	12,092
営業利益	18,124	31,752
営業外収益		
受取利息	4	27
受取配当金	6	7
その他	8	12
営業外収益合計	20	47
営業外費用		
支払利息	18	8
為替差損	17	481
その他	0	8
営業外費用合計	35	498
経常利益	18,108	31,302
税金等調整前四半期純利益	18,108	31,302
法人税、住民税及び事業税	5,214	8,477
法人税等調整額	△687	625
法人税等合計	4,526	9,103
四半期純利益	13,582	22,198
親会社株主に帰属する四半期純利益	13,582	22,198

(四半期連結包括利益計算書)  
(第2四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 2022年7月1日 至 2022年12月31日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2023年7月1日 至 2023年12月31日)
四半期純利益	13,582	22,198
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	375	34
為替換算調整勘定	△422	△220
退職給付に係る調整額	—	0
その他の包括利益合計	△47	△186
四半期包括利益	13,535	22,012
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	13,535	22,012
非支配株主に係る四半期包括利益	—	—

## (3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 2022年7月1日 至 2022年12月31日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2023年7月1日 至 2023年12月31日)
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		
税金等調整前四半期純利益	18,108	31,302
減価償却費	1,621	2,219
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	10	△24
賞与引当金の増減額 (△は減少)	585	592
役員賞与引当金の増減額 (△は減少)	△465	△496
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	5	12
株式給付引当金の増減額 (△は減少)	137	412
受取利息及び受取配当金	△11	△35
支払利息	18	8
為替差損益 (△は益)	43	736
売上債権の増減額 (△は増加)	△7,515	8,329
棚卸資産の増減額 (△は増加)	△29,010	△10,515
仕入債務の増減額 (△は減少)	2,107	4,840
前受金の増減額 (△は減少)	38,083	△3,229
その他	107	701
小計	23,824	34,851
利息及び配当金の受取額	11	35
利息の支払額	△18	△8
法人税等の支払額	△4,679	△15,925
営業活動によるキャッシュ・フロー	19,139	18,952
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
有形固定資産の取得による支出	△17,609	△1,444
無形固定資産の取得による支出	△491	△457
差入保証金の差入による支出	△10	△15
投資活動によるキャッシュ・フロー	△18,112	△1,916
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>		
短期借入金の純増減額 (△は減少)	10,000	△5,000
配当金の支払額	△5,861	△11,543
その他	△2	△7
財務活動によるキャッシュ・フロー	4,135	△16,551
現金及び現金同等物に係る換算差額	415	379
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	5,578	864
現金及び現金同等物の期首残高	23,420	29,773
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	209	—
現金及び現金同等物の四半期末残高	29,209	30,638

(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

## 3. 補足情報

## (1) 品目別生産実績

第2四半期連結累計期間における生産実績を品目ごとに示すと、次のとおりであります。

品 目		前 期	当 期	対前年同四半期増減率
製 品		百万円	百万円	%
	半導体関連装置	102,764	89,506	△12.9
	その他	1,701	1,715	0.8
	小計	104,466	91,222	△12.7
サービス		9,281	13,000	40.1
合計		113,747	104,222	△8.4

(注) 金額は販売価格で表示しております。

## (2) 品目別受注高及び受注残高

第2四半期連結累計期間における受注状況を品目ごとに示すと、次のとおりであります。

品 目		受 注 高			受 注 残 高		
		前 期	当 期	対前年 同四半期 増減率	前 期	当 期	対前年 同四半期 増減率
製 品		百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
	半導体関連装置	78,974	59,630	△24.5	398,519	369,022	△7.4
	その他	4,248	500	△88.2	5,526	6,156	11.4
	小計	83,223	60,130	△27.7	404,046	375,178	△7.1
サービス		11,159	12,405	11.2	4,439	5,300	19.4
合計		94,383	72,535	△23.1	408,485	380,479	△6.9

(注) 1. 金額は販売価格で表示しております。

2. 受注高には受注取消・変更等による調整額が含まれております。

## (3) 品目別販売実績

第2四半期連結累計期間における販売実績を品目ごとに示すと、次のとおりであります。

品 目		前 期	当 期	対前年同四半期増減率
製 品		百万円	百万円	%
	半導体関連装置	44,566	81,071	81.9
	その他	1,253	917	△26.8
	小計	45,819	81,989	78.9
サービス		9,281	13,000	40.1
合計		55,100	94,989	72.4